

東洋インキ 未来のパッケージを切り拓く 環境対応ソリューションを紹介

東洋インキ株式会社

artienceグループの東洋インキ株式会社（代表取締役社長 安田秀樹、東京都中央区）は、グループ2社とともに、2024年10月23日（水）～25日（金）に東京ビッグサイト（東京都江東区）にて開催される「東京国際包装展（TOKYO PACK 2024）」に出展します。

「技術と感性が描く未来」を出展コンセプトに掲げ、持続可能な社会の実現に向けた各種環境対応パッケージソリューションを展示します。

- ・プラスチック包装におけるマテリアルリサイクルへの取組み
- ・軟包装分野における紙化、プラスチック使用量削減（モノマテリアル化など）の取組み
- ・パッケージにおけるバイオマス、水性・無溶剤の取組み

同時に、パッケージの高意匠化をテーマに、UVスクリーンインキやグラビアインキ、構造色シート等のパッケージデザインに新たな可能性を広げる製品・ソリューションも展示します。

<https://www.artiencegroup.com>